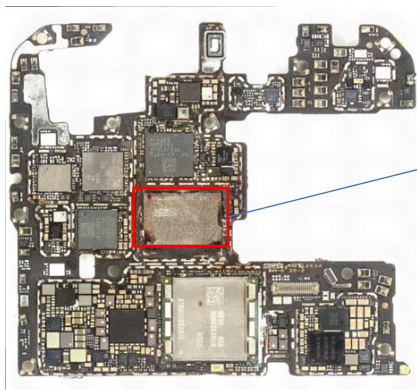


4D NAND フラッシュメモリ：SK hynix (HUAWEI Mate 80 Pro搭載)
構造解析レポート

HUAWEI Mate 80 Pro搭載基板



3D NAND パッケージ

レポート背景と概要

生成AIとデータセンターの爆発的な拡大により、大容量且つ高速な3D/4D NANDフラッシュメモリの需要が急拡大しています。

今回、2025年11月に発売されたHUAWEI Mate 80 Pro搭載のSK hynix製4D NANDフラッシュメモリの構造解析レポートをリリースします。

製品特徴

HUAWEI Mate 80 Pro搭載品 製品リリース日(Mate 80 Pro)：2025年11月

SK hynix 4D NANDフラッシュメモリ

解析内容 & レポート価格

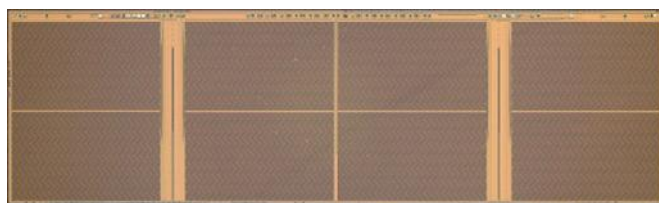
構造解析レポート 価格：¥300,000 (税別) 発注後1weekで納品

- ・1PKG内にフラッシュメモリチップは、8チップ搭載され、インターフェースICチップも搭載されている。
- ・概要解析として、メモリセル部断面解析 (WL, BL方向)を行い、構造確認、メモリゲート積層数の確認、を行っています。

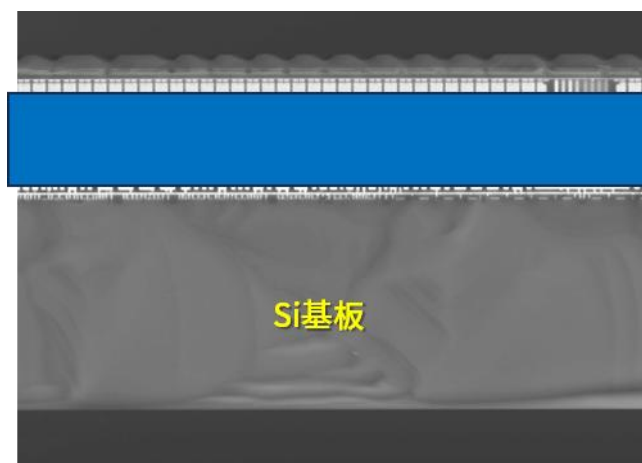
構造解析レポート目次

	Page
1. デバイスサマリー	3
2. 製品分解	4
3. パッケージ観察	5
4. X線観察	6
5. チップ観察	7
6. 断面構造解析	10

構造解析レポートからの抜粋



4D NANDチップ写真



メモリセルの断面SEM像